

公司代码：600520

公司简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润为15,041,974.59元，加上年初未分配利润-348,070,696.14元，合计为-333,028,721.55元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

经审计，截至2025年度末，母公司未弥补亏损30,303.52万元，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司暂不具备利润分配条件，本年度公司不进行分红。

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三佳科技	600520	文一科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
----------	-------	--------

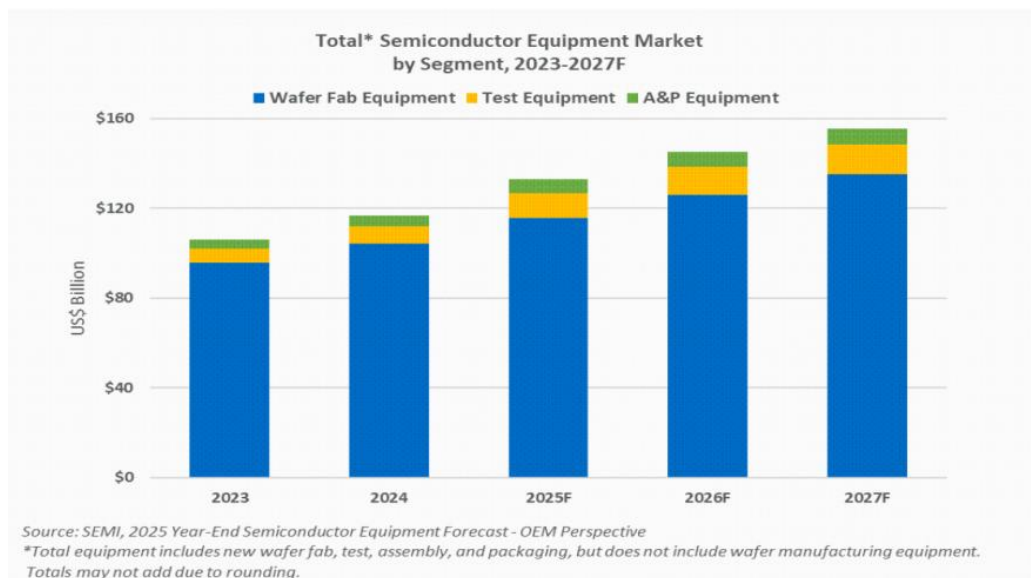
姓名	夏军	毕静
联系地址	安徽省铜陵市铜官区何村路三佳公司	安徽省铜陵市铜官区何村路三佳公司
电话	0562-2627520	0562-2627520
传真	0562-2627555	0562-2627555
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业基本情况、发展阶段、基本特点

(1) 半导体封装装备板块

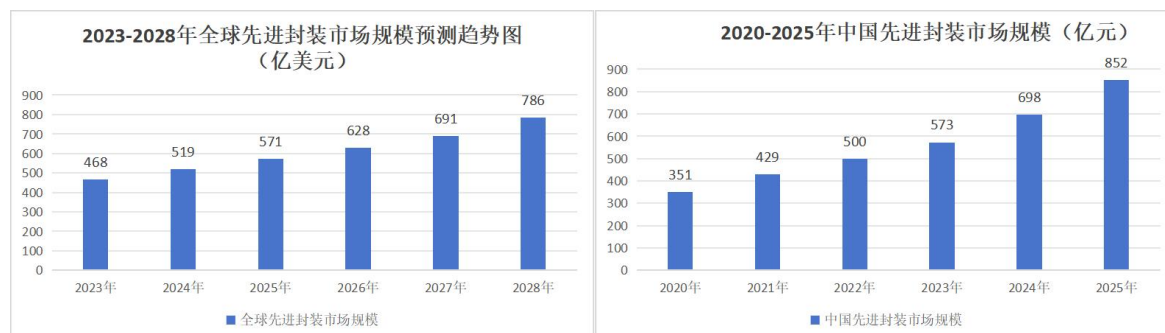
半导体封装装备行业具有较高的全球化程度与技术门槛，其发展受宏观经济、行业资本开支、技术迭代及终端消费市场需求等多重因素影响，呈现出明显的周期性特征。2022 年至 2023 年，半导体封装行业处于下行周期。根据 SEMI 数据，2023 年全球半导体封装设备的销售额同比下降 30%。自 2024 年，伴随 AI、云计算、消费电子、汽车电子和工业自动化等终端需求持续释放，全球半导体行业快速回暖，带动半导体设备投资大幅回升。根据 SEMI 数据，2025 年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额预计达 1330 亿美元，同比增长 13.7%，创历史新高；2026 年、2027 年有望继续攀升至 1450 亿和 1560 亿美元。在半导体后道设备领域，2025 年延续 2024 年开启的强劲复苏势头。根据 SEMI 数据，2025 年全球半导体封装设备销售额达 64 亿美元，同比增长 19.6%，2026、2027 年预计增长 9.2%和 6.9%。



数据来源：SEMI

在细分领域，受半导体行业资本开支阶段性调整影响，传统塑封设备订单增速放缓。然而，在 AI、存储及高性能计算需求拉动与创新技术驱动下，全球先进封装市场保持高速增长态势。根据中商产业研究院数据，2024 年全球先进封装市场规模达 519 亿美元，同比增长 10.90%，预计

2025年增长至571亿美元，2028年有望进一步攀升至786亿美元。其中，中国先进封装市场增速高于全球整体增速，由2020年的351亿元增长至2024年的698亿元，年复合增长率为18.7%，预计2025年增长至852亿元。



数据来源：中国产业研究院、中商情报网

数据来源：中国产业研究院、中商情报网

(2) 智能制造板块

1) 塑料挤出模具及配套设备领域

公司塑料挤出模具及配套设备主要用于生产具有连续形态的塑料型材制品，业务聚焦于节能门窗、环保装饰等高端应用领域，其发展受全球宏观经济、房地产周期、建筑业和能效标准、贸易政策、原材料（PVC树脂）价格波动等因素影响。报告期内，国内房地产市场面临多重发展挑战，大型门窗塑料型材生产企业采取减产、停产及转型等举措，国内挤出模具市场需求长期处于较低水平。从国际市场看，北美、欧洲、土耳其等地区建筑节能标准要求较高，高端节能塑料门窗的市场需求量旺盛，对塑料挤出模具质量及精度要求高。中亚、东南亚、非洲、南美等地区正处于工业化、城市化加速期，对高性价比挤出模具需求较大，发展势头强劲。

2) 冲压轴承座及配套密封件领域

带式输送机械是港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业实现大宗物料长距离、连续性输送的关键装备。公司轴承座及其密封件产品为带式输送机托辊的核心组成部分，其性能与运行可靠性，直接决定了整机系统的运行效率、使用寿命及能耗水平，是影响输送工程经济效益的关键一环。

当前，我国带式输送机行业发展已趋于成熟，在全球市场中具备较强的综合竞争力。据中国重型工业协会统计，2025年全年物料搬运机械行业进出口总额达395.52亿美元，同比增长10.63%；其中出口额370.45亿美元，同比增长12.42%，进口额25.08亿美元，同比下降10.44%。与此同时，行业发展也面临多重挑战。受宏观经济增速放缓、关税政策调整、行业竞争日趋激烈等因素影响，带式输送机下游钢铁、水泥、煤炭、港口、砂石骨料等核心关联产业需求出现下滑，重大带式输

送机项目推进节奏有所放缓。低价竞争、资金回收困难、行业整体利润率下滑等问题，已成为当前行业内普遍存在且亟待解决的痛点。在此背景下，下游客户持续加大研发投入，着力打造更高效、更智能、更环保的带式输送机，产品应用场景不断拓宽。高精度、环境适应性强、使用寿命长的冲压轴承座及密封件市场需求持续提升，行业结构性升级趋势明显。

2.2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）半导体封装装备板块

半导体塑封设备市场的行业集中度较高，全自动塑封设备及先进封装设备主要由 TOWA、YAMADA、ASM、BESI 少数海外企业占据主要市场份额。国内企业则主要集中于手动塑封设备及全自动塑封设备领域，近年来国产化率持续提升。公司拥有省级技术中心、省级工业设计中心、安徽省集成电路先进封装装备重点实验室和安徽省级博士后科研工作站等技术创新平台，先后承担国家重大科技专项、安徽省重大科技专项等，并主持起草了多项国家标准和行业标准，是少数具备全自动塑封设备及先进封装设备自主研发与生产能力的国产厂商之一。本公司与众合半导体在产品研发及市场占有率方面位居国产厂商前列。报告期内，公司完成对众合半导体控制权的收购，有效整合了双方资源，提升了公司在产品研发、市场开拓、供应链管理等方面的综合能力，丰富了产品品类，增强了品牌影响力，进一步扩大了市场份额与客户覆盖面，行业地位得到显著提升。

在先进封装设备（塑封）领域，由 TOWA、YAMADA 等海外龙头厂商垄断。为满足下游客户持续攀升的先进封装设备需求，报告期内公司集中核心研发资源，围绕先进封装设备开展技术攻坚，取得了关键性突破。其中，重点攻关项目“100×300mm 以内基板类压缩成型封装自动化设备关键技术研发及产业化”及“扇外型晶圆封装模具设计及制造关键技术”分别入选安徽省科技厅“科技创新攻坚计划”和安徽省工信厅“揭榜挂帅”攻关任务名单，标志着公司在先进封装核心技术领域的研发实力获得了高度认可，为公司后续抢占先进封装设备市场，推动国产化进程打下坚实基础。

（2）智能制造板块

1) 塑料挤出模具及配套设备领域

塑料挤出模具及配套设备领域行业集中度较高，由奥地利格瑞纳（Exelliq）占据主要市场，其他主要市场参与者包括本公司、耐科装备等。经过多年经营，公司拥有国际一流的加工和调试设备，具备高端挤出模具及设备制造能力，可满足下游客户各类需求。公司品牌历史悠久，在欧洲、北美设有销售服务网点，产品出口至全球 60 余个国家和地区，拥有稳定的大客户群。

2) 冲压轴承座及配套密封件领域

公司现为中国带式输送机行业协会理事单位、《带式输送机托辊冲压轴承座基本参数与尺寸》行业标准的起草编制单位，中国重型机械工业专精特新冠军单位，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，公司产品质量、规模、技术、出口量均位于行业前列。相较于山东裕鑫、绍兴华运等国内竞争对手，公司依靠较强的新品研发能力、全自动与全配套生产能力与国际品牌影响力，主要聚焦中高端市场，客户涵盖意大利 RULMECA、科大重工、山特维克、中煤集团、蒂普拓普等国内外知名矿山机械企业，客户满意度长期保持较高水平。

2.3 公司所处行业未来发展趋势

（1）半导体封装装备领域

在塑封设备领域，下游客户对设备的精度、良率与稳定性要求逐步提高，正逐步摆脱传统手动塑封设备，向高精度自动化设备升级。同时，在国家鼓励设备更新等政策引导下，下游客户老旧手动设备的更新换代需求空间较为旺盛。

相较于台积电、日月光等海外厂商，中国大陆封测厂商以传统封装为主，先进封装业务比重较低。报告期内，人工智能技术的突破带动数据中心芯片、高速网络芯片以及高带宽内存（HBM）爆发式增长。后摩尔时代，为打破存储墙、面积墙、功耗墙与功能墙限制，以 Chiplet、2.5D、3D 封装与异构集成为代表的先进封装技术发展日益成熟。下游客户持续加码对先进封装工艺的研发投入，扩充先进封装产能，加速了封装行业工艺、设备与材料技术的迭代升级。然而，目前先进封装核心设备与材料供应主要由日韩把控，供应链存在潜在风险。国产半导体封装设备厂商迎来关键发展窗口期，需加速先进封装产品研发，在抢占国内增量市场的同时，降低国内封测厂商供应链风险。

报告期内，公司着力建设合肥研发中心，旨在集中研发资源、提高管理质效、吸引研发人才、借助合肥产业、人才、政策及科创资源优势，聚焦晶圆级、板级先进封装设备及模具研发，加速公司先进封装业务进程。

（2）智能制造板块

1) 塑料挤出模具及配套设备领域

下游市场对塑料挤出模具的挤出速度、节能环保等方面提出了更高要求。模具主材挤出速度需达到 5—6 米/分钟以上，且成型表面必须无收缩痕、亮暗线或水波纹等瑕疵。复合材料应用日益广泛，如通过多种材料共挤复合技术（如 PVC+PBT 聚酯合金等）实现材料性能优化。此外，以 ABS、PP、PC、PMMA 为代表的非门窗类工程塑料挤出技术正迅速发展，成为推动行业持续增长的重要方向。

2) 冲压轴承座及配套密封件领域

在行业结构性升级和节能减排政策双重推动下，市场主流需求加速转向长寿命、免维护、轻量化、环保的托辊及轴承座密封件。技术方面，在高精度高可靠性的要求下，公司冲压轴承座全自动生产呈现明显优势；密封技术从单一结构转向组合式迷宫密封、接触式密封，能够更好地适应高粉尘、淋水、浸水等极端工况环境。材质方面，传统钢制托辊仍占国际市场主流，但非金属托辊的应用日益广泛。以聚乙烯托辊、聚氨酯托辊为代表的产品，因其轻量化、耐腐蚀、节能环保和低噪音等优势，在特定工况中的应用占比持续提升。密封件产品呈现多元化发展趋势，针对不同工况需求，需实现阻燃、抗静电、耐低温等差异化性能，以满足下游客户的多样化应用场景。


报告期内，为应对行业新机遇与挑战，公司已完成全自动机器人冲压、注油、落料生产线建设；已完成超高分子量聚乙烯托辊及配套塑料轴承座新品研发；加强密封结构迭代升级和专利技术储备。

2.4 核心业务与产品

公司经过多年发展，目前核心业务涵盖半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等；智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。



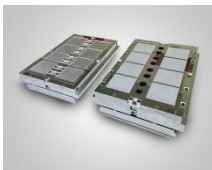




(1) 半导体封装装备

半导体封装装备主要应用于集成电路、功率器件与分立器件的封装工序，主要客户涵盖国内外头部封测及 IDM 厂商。报告期内，公司加速产业整合，完成对众合半导体收购，进一步提升市场占有率与行业竞争力；同时，公司积极构建全球化市场布局，成功导入 ST、UNISEM 等国际客户供应链，海外市场开拓成效显著。主要产品如下表：

产品类别	产品名称	基本介绍	产品特点	竞争优势	示例图
半导体封装装备	FSAM 120 自动封装系统	设备通过伺服电机驱动，实现塑封工序上料、合模、注塑、下料、冲流道等全流程自动化。适配引线框架宽度 20-75mm、长度 124-250mm；合模压力 20-120 吨；系统最小机械时间达 28 秒。主要应用于 SOP、SOT、QFN 等常规封装品类。	产品换型仅需更换模盒、交换部，人机界面设置参数即可，操作简单。核心部件适配国内工艺，配件供应稳定，维护便捷，技术成熟。采用肘节式压机、齿轮齿条式机械手，满足常规封装工艺精度要求。	国内最早实现量产的封装系统，打破日本企业垄断，填补国内常规封装自动化设备空白。采购、配件、维护成本远低于进口设备，贴合国内中小封测企业预算与工艺需求。落地 200 余套，服务众多国内封测企业，设备稳定性满足量产需求，客户认可度高。	

FSAM 180 自动封装系统	在结构、性能上全面优化，合模压力 20-180 吨，适配引线框架宽度 20-100mm、长度 124-320mm，兼容更宽更长的高端引线框架，MTBA>2h、MTBF>72h，可满足 BGA、QFP 多引脚高端集成电路的封装需求。	通过 180 吨肘节式五连杆斜排列电动压机结构升级，合模丝杆固定方式优化，提升吨位、精度与受力均匀性；采用全新设计的上料结构，适配倒装、多引脚及高脚位产品。	国内首款对标国际 180 吨级的封装系统，打破国际高端市场垄断。技术创新贴合生产痛点，拥有树脂称重、防偏检测、防混批等功能，可精准解决封装生产中来料缺陷、产品偏移、批次混料等问题，提升产品良率。	
FSDM 180 双注塑自动封装系统	主要用于功率器件、钎电容等较窄产品的全自动封装，适配 55*300mm 以内的引线框架，为模块化设计的全自动装置。	模块化设计，集成引线框架与树脂自动供给、上下料、压机、模具及制品自动去胶收集等功能；改变单排注塑形式，采用双排列注塑单元。	适配窄型产品封装，一台压机可封装 4 个 L/F，产能提升一倍，电力消耗、人力需求和场地需求均减半。	
FSPM 180 自动封装系统	针对高品质封装要求的自动封装系统，配置移动预热台，双丝杆驱动框架式压机结构，适用大尺寸宽度产品封装。覆盖多种封装类型，适配汽车电子、存储芯片、高性能计算等领域的多样化封装需求。	从料盒到旋转台采用全新架构，稳定高效。采用高刚性板式压机，自动润滑系统，注塑平稳，适配高精度封装。配置完善，封装过程更加自动化，封装环境更加洁净。	两点夹持/探针式牵引结构，减少出料摩擦与抖动；移动预热台，同步预热，避免产品入位困难；成形过程中压力平衡，抑制溢胶、芯片裂纹；复式顶出结构，受力均匀，减少产品变形。	
200T 双注塑自动封装系统	设备通过伺服电机驱动，实现塑封工序上料、合模、注塑、下料、冲流道等全流程自动化。适配引线框架宽度 20-85mm、长度 124-300mm；合模压力 20-200 吨；系统最小机械时间达 33 秒。主要应用于 SOP、SOT、QFN 等常规封装品类。	采用肘节式压机、齿轮齿条式机械手，树脂排列采用直振式机构；满足常规封装工艺精度要求。产品换型仅需更换模盒、交换部，人机界面设置相关参数即可，操作简单。核心部件适配国内工艺，配件供应稳定，维护便捷，技术成熟。	一台压机可封装 4 个 L/F，产能提升 80%，人力需求和能耗需求减半。	
280T 双注塑自动封装系统	设备通过伺服电机驱动，实现塑封工序上料、合模、注塑、下料、冲流道等全流程自动化。适配引线框架宽度 20-110mm、长度 124-310mm；合模压力 20-280 吨；系统最小机械时间达 35 秒。主要应用于 SOP、SOT、QFN	采用肘节式压机、齿轮齿条式机械手，树脂排列采用直振式机构；满足常规封装工艺精度要求。产品换型仅需更换模盒、交换部，人机界面设置相关参数即可，操作简单。核心部件适配国内工艺，配件供应稳定，维护便捷，技	一台压机可封装 4 个 L/F，产能提升 80%，人力需求和能耗需求减半。	

		等常规封装品类	术成熟。		
	晶圆级塑封设备	集成电路先进封装工艺压缩成型塑封专用装备，适配晶圆级 WLP/面板级 PLP 等形式的压缩成型塑封，含压机、覆膜、高真空、精密模具等核心单元，搭配多项辅助机构。	适配 flange mold 和 full mold 两种塑封型式，可处理液体、颗粒树脂；支持 8 寸、12 寸、直径 320 规格载板；配备自动挤胶、撒粉机构及模具更换专用小车。	专为先进封装工艺设计，塑封型式、树脂类型、载板规格适配范围广；伺服同步控制技术可自动调节塑封体厚度一致性，保障先进封装的工艺精度。	
半导 体 筋 切 成 备	装盘类自动冲切成型系统	适用于 QFP、LQFP、TSOP 类产品的自动上料、成型、分离、自动装盘等工序。	单元组合式结构，可适用最多 8 排产品的步距变换及整列，可根据产品类别定制化设计。	系统通用性高，适用范围广，运行稳定性高，根据工艺需求，可匹配齿形料盒上料单元，适配自研的视觉系统满足定制化迭代需求。	
	全自动换管切筋成型系统	适用于 SOP、MSOP、TSOP 类产品的自动上料、切筋、成型、分离、全自动装管等工序。	单元组合式结构，产品收纳采用全自动换管方式，料管自动分选、自动整列、自动输送、自动装管、自动收集，有效降低劳动强度，提高生产效率。	系统通用性高，适用范围广，运行稳定性高。客户可根据需要选择凸轮式和丝杆式分离结构；适配自研的视觉系统满足定制化迭代需求。	
	单元组合式自动切筋系统	适用于 SOP、QFP、SOT 光耦类产品的自动上料、冲塑、切筋、自动下料等工序。	单元组合式结构，模具冲切、浮动板上下、拨爪送料等动作按时序由凸轮组匹配完成。	系统通用性高，适用范围广，运行稳定性高，根据工艺需求，可匹配齿形料盒上、下料单元；适配自研的视觉系统满足定制化迭代需求。	
	SOT类自动冲切成型系统	适用于 SOT/SOD 类产品的自动上料、冲塑、切筋、成型、散装收料等工序。	条带输送采用高速电机驱动，通过边框拖动塑封体完成产品的成型及分离。	冲切速度 160 次/分钟，条带输送、探针检测、模具冲切等动作按时序由电子凸轮匹配完成，稳定可靠；适配自研的视觉系统满足定制化迭代需求。	
	光耦类自动冲切成型系统	适用于 DIP817/SOP817 光耦类产品的自动上料、切筋、成型、自动装管等工序。	双料盒、双升降机的上料方式，曲柄滑块式伺服冲头，具有冲切压力补偿功能。	成型方式有直插式、鸥翅式及 M 型，分别采用滚轮打弯及 CAM 成型的结构，减轻产品擦锡，提高产品品质。	
	多排 TO 类自动冲切	适用于 6 排/8 排 TO252 产品的自动上料、冲塑、切筋、成型、分离、自动装管等工序。	引线框架传送采用整体拨爪送料，曲柄滑块式伺服冲头，具有冲切压力补偿功能。	分离模采用下拨爪结构，运行稳定性高，具有散装收料及装管收料的组合功能。	

成型系统					
标准 MGP 塑封模具	标准结构 MGP 模，按产品外形和客户需求有两组、四组、六组、八组等结构，可适用于 SOT, TO, SOP, DIP, TSSOP 等绝大部分半导体产品封装。	采用免预热小直径树脂，多个料筒注射封装，流道设计采用等流长技术，产品封装效率高，成型工艺稳定可靠。	模具在长期使用情况下，可保持结构稳定；油路零件更换便捷。		
抽真空 MGP 模具	抽真空 MGP 模，按产品外形和客户需求有两组、四组、六组等结构。	整体式真空围板设计配合大功率真空泵，可有效减少产品内部及表面的气孔及空洞，适用于车载产品的封装。	可在很短时间内形成模具内部的负压，真空度最高能达到-0.1MPa。		
标准自动封装模具	适用于标准 120T, 180T 自动封装系统上生产。其中 180T 设备上模具，最大适用的引线框架外形可达到 300mm*100mm。	多重导向定位设计和模盒快换机构。	可满足封装产品的外形公差±0.025mm，偏错位小于等于 0.038mm。		
半导体封装模具	抽真空结构自动模具，适用于 QFN、BGA 以及对内部气孔、分层等要求较高的车载产品。	模架内置真空管路。	真空度可调，抽真空速度快。		
抽芯自动封装模具	抽芯结构模具，适用于 IPM、IGBT 等大型模块类产品，以及一些散热片需外露的产品封装。	可实现上抽芯，下抽芯，上下同时抽芯等不同产品需求，还可以配套抽真空负压成型技术的应用。	对于大型模块类封装产品，可控制基岛在产品中的相对位置，还可以减少外露散热片的溢料。		
覆膜自动封装模具	覆膜封装结构模具，适用于晶片外露的基板类封装产品。	覆膜的吸附采用多重吸附技术，配合滚动覆膜结构，可以解决离型膜吸附过程中褶皱的问题。	可使离型膜完全贴合型腔，并能减少晶片表面的溢料面积。		
多注塑单元自动封装模具	适用 180T 自动封装系统的双排注塑结构模具和四排注塑结构模具。	采用多个注塑单元，相较于普通自动封装系统，单压机封装产能翻倍。	适用于 TO、SOD、SOT、钽电容等产品封装，可提高产品品质与产能。		



(2) 智能制造业务

1) 塑料挤出模具及配套设备领域

公司“Trinity”品牌作为行业内历史悠久的挤出模具品牌，拥有成熟的加工制造技术与广阔稳

固的市场网络。公司产品广泛应用于 PVC 门窗型材、板材、装饰型材等领域，主要涵盖两大品类：一是挤出模具，包括高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具，以及各类非门窗类、非 PVC 类定制化挤出模具；二是挤出机下游配套设备，包括定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机、共挤机等。公司产品主要面向中高端市场，客户群体为全球各地区中高端 PVC 塑料异型材生产企业，覆盖全球 200 多家客户，产品远销 60 多个国家和地区。报告期内，公司通过对接欧洲知名门窗企业、参展德国 K 展等，成功与德、俄等地区 6 家高端企业建立合作。主要产品情况如下：

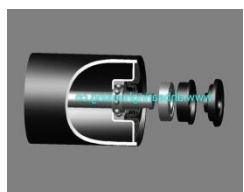
产品类别	产品名称	基本介绍	产品特点	竞争优势	示例图
塑料异型材挤出模具	单腔挤出模具	欧式和美式主型材的高速挤出模具	可挤出大截面、多腔室、断面复杂的主型材产品	产品的熔体压力、模头和定型模的尺寸匹配设计更合理，加工制造精度高。	
	多腔挤出模具	主型材双腔挤出和辅型材多腔挤出模具	一套模具能同时挤出多根相同（或不同）的主型材产品，可大幅提高生产速度，降低成本。	模头的料流分配技术，保证各腔料流分配均匀和高速生产的稳定性。双腔主型材模具挤出速度可达 4m/min、4 腔（或更多腔）辅型材模具挤出速度可达 6-8m/min，为用户提供最大化的生产效率。	
	共挤挤出模具	可将两种或多种不同物料在同一个模具内或模具口汇合，一次性挤出形成多层复合制品。	根据不同材料的特性和用户需求，提供共挤流道设计方案，可实现 PVC/PMMA/ASA 等材料的表面共挤、回收 PVC 废塑共挤、全包覆共挤及软硬共挤，保证共挤层的均匀性和表观质量。	从表面共挤到废塑共挤、全包覆共挤等，可为用户提供多种方案。	
	宽幅板类挤出模具	400mm 至 900 mm 宽度的异形板材模具。	流线型的流道设计，保证产品壁厚均匀。特殊的加固结构，可解决板块间溢料、支撑筋断裂现象。	提供多种定型模开启方案，方便生产操作，满足客户需求。生产效率高，可实现模具挤出产能 800kg/h。	
	发泡类型材挤出模具	用于生产具有泡孔结构的发泡塑料型材的模具。	采用 CELUKA 挤出发泡成型法，在单螺杆或双螺杆挤出机上生产，实现表层致密的低密度门窗及装饰类型材。	独特的内腔排气技术，确保挤出型材内部无明显气孔，向客户提供合格的发泡制品。	
塑料异型材挤	定型台	塑料型材挤出设备，将模具口挤出的型坯进行冷却定	整体不锈钢框架，坚固耐用，含单腔、双腔、宽幅板材等不同类型定型台。	在模具配套装置方面，公司依托多年技术积累与客户经验，具备优秀的装置	

出配 套装 备		型和精整，适用于生产所有类型的塑料型材。		设计能力，可满足下游客户各类定制化需求，快速响应。	 
	牵引 切割 机	为型材生产提供牵引和定长切割的装备。	一体机或分体结构，锯片切割或热刀切割，可满足用户的不同需求。		
	共挤 机	可实现 PVC/PMM A/ASA 颗粒料的表面共挤、TPE/EPDM/SPVC 软胶条共挤的设备。	螺杆直径 20-50mm，挤出产量 3~25kg/h 的小型单螺杆共挤机，可以满足表面共挤、胶条前共挤和后条共挤的设备。		

2) 冲压轴承座及配套密封件领域

公司全资子公司建西精密专注于带式输送机托辊用冲压轴承座及配套密封组件的研发、设计、制造和销售，同时开展各类精密金属冲压件、注塑件的研发生产。作为行业标准起草单位及多项荣誉获得者，是国内该领域主要生产基地及领军企业。产品覆盖 DTII、TK、TKII、TKIII 四大系列托辊所需的 600 多个型号冲压轴承座及密封组件，广泛应用于矿山、港口、钢厂、水泥、煤矿等领域的长距离带式输送机散料输送项目。产品出口至美国、印度、智利、巴西、澳大利亚等 30 多个国家和地区。报告期内，技术研发部门以客户市场需求为导向，聚焦项目交付和研发成果转化，为公司产品竞争力提升与销售业绩增长提供了坚实的技术支撑，先后完成了 TKN407、TKN309、TKN310、STKIII312、意大利 SIS-NTKIII6204、美洲托辊 AR6308、墨西哥 JPC6204 七个系列轴承座及密封组件新产品的模具设计和研发工作，为公司销售业绩带来新的增长点。主要产品情况如下：

产品类别	产品名称	基本介绍	产品特点	竞争优势	示例图
冲压轴承座及密封组件	DTII 型	该密封组件用于带式输送机 DTII 型托辊制品组装，主要用于国内煤矿带式输送机工程项目。	每套八件，包括轴承座、底密封圈、内外迷宫密封圈、密封环、内挡圈、外挡圈、挡板组成。	冷挤压多次拉伸成型工艺，无引申毛刺，外观光洁，非接触式密封，旋转阻力和防水防尘性能良好。	
	TK 型	该密封组件用于带式输送机 TK 型托辊制品组装，广泛用于国内外各种工况环境下带式输送机工程项目。	每套六件，包括轴承座、底密封圈、内外迷宫密封圈、罩盖、防护罩组成。	非接触式密封，旋转阻力和防水防尘性能良好，罩盖与迷宫密封圈装配接触面大，不易脱落，特别适合全自动托辊生产线装配。	
	TKIII 型	该密封组件用于带式输送机 TKIII 型托辊制品组装，主要用于国内外工况环境	每套七件，包括轴承座、底密封圈、内外迷宫密封圈、密封盖、橡胶圈、防护罩	接触式密封，旋转阻力稍大，防水防尘性能优越，罩盖与迷宫密封圈装配接触面	

		特别恶劣、对托辊制品防水防尘性能要求特别高的带式输送机工程项目。	组成，成本比其他密封组件略高。	大，不易脱落，适合全自动托辊生产线装配。	
	TKII 型	该密封组件用于带式输送机 TKII 型托辊制品组装，主要用于国内外露天厂矿作业环境良好的轻型带式输送机工程项目。	每套三件，包括轴承座、内外迷宫密封圈部件组成。	非接触式密封，旋转阻力小，防水防尘性能一般，性价比较高，托辊质量较轻。	

2.5 经营模式

（1）盈利模式

公司主要从事半导体封装设备及模具、挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件的研发、生产与销售，通过向下游封测厂商、塑料异型材生产制造公司及带式输送机生产制造公司等提供产品和服务实现收入与利润。

（2）研发模式

公司采用自主研发为主的模式，构建了以技术研发部门为核心、各专业团队为协同支撑的研发体系，研发工作紧密围绕客户需求与行业技术发展趋势展开，确保技术创新与市场需求同频共振。公司建立了贯穿项目全周期的规范化研发流程，涵盖项目调研、可行性分析、立项、设计开发、试制验证及验收总结等关键环节，为研发项目的顺利推进与成果转化提供了坚实保障。通过积极参加行业展会与技术论坛，深化产学研合作等方式，公司持续把握业内前沿技术动态，有效整合创新资源，不断提升技术洞察与前瞻布局能力。

公司推行多元化激励机制，激发研发团队的创新活力与积极性。同时，公司持续加大研发投入力度，聚焦核心技术攻关与产品迭代升级，加速研发成果向产业化应用转化。

（3）采购模式

公司采用“以产定购为主、合理备库为辅”的采购模式，建立了完善的采购管理体系和标准化管控流程，遵循公开公平公正原则开展采购工作。采购部门依据公司战略规划及下年度经营目标编制年度采购计划，以年度采购计划为基础，结合当期销售订单、安全库存状况以及实际需求，编制日常采购计划并执行。在采购定价方面，公司遵循市场化原则，并通过多渠道比价择优确定供应商，持续提高成本管控水平。公司搭建了完善的供应商准入、动态评价及淘汰机制，对供应商资质、供货品质进行全方位把控，并与主要供应商保持长期稳定的合作关系，确保供应链的高效可靠。

（4）生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，围绕客户订单需求开展设计、制造、组装调试及一体化解决方案交付，同时对部分标准件实行库存式生产，以缩短生产响应时间、提升生产效率。公司建立了完善的质量管理体系，通过多环节检验严格把控产品质量，并运用 ERP 系统提升生产管理效率。在生产环节方面，核心工艺、产品设计、精密加工、装配、调试及验证等关键工序均由公司自行完成；对于工艺相对简单、附加值较低的工序，公司采用外协配套加工模式，并全程把控质量标准，确保外协产品合格后进入下一道工序。

（5）销售模式

公司构建了多元化、立体化的全球销售体系。国内市场以直销为主，海外市场采用“直销+区域代理”相结合的模式，辅以网络销售、电商平台等数字化渠道，有效突破地理、语言及文化壁垒。在销售定价方面，公司遵循市场化与定制化相结合的原则，依据产品技术指标、客户个性化需求及市场供需关系实行差异化定价。客户合作以深度技术协作为纽带，通过“联合研发+定制交付+全周期服务”的模式，持续深化与客户的战略合作关系，显著提升客户满意度与忠诚度。同时，公司积极参加各类行业展会拓展市场、提升在全球范围内的品牌知名度和影响力。

2.6 业绩驱动因素

公司业绩主要依托产品创新、市场拓展、成本控制及生产优化四大因素驱动。

产品创新方面，公司持续加大研发投入，聚焦核心技术攻关与新产品开发，推动技术成果转化，有效提升客户黏性及订单转化率，并通过技术升级适配市场多样化需求。

市场拓展方面，公司积极布局国内外市场，通过参加行业展会、拓展电商渠道、合作区域代理等方式开拓新市场、积累优质客户资源。顺应行业发展趋势，快速切入 AI 算力芯片封装、车规级 SiC 模块封装等高增长赛道，深耕高端市场，扩大市场份额。

成本控制方面，公司强化全流程成本管控，通过优化采购策略、深化精益生产、提升设备效率等措施，有效抵御成本波动。持续完善预算与成本责任体系，整体成本控制成效显著。

生产优化方面，公司大力推进生产自动化升级，完善质量管理体系，优化生产流程与缩短交付周期，有效提升生产效率与产品品质，保障订单按期交付，为业绩增长提供坚实支撑。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年	2023年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	918,166,135.31	560,205,340.45	63.90	598,649,628.06
归属于上市公司股东的净资产	391,632,223.54	379,549,333.51	3.18	353,825,025.25
营业收入	378,516,364.42	314,375,318.84	20.40	330,685,024.52
利润总额	10,327,687.79	23,482,586.60	-56.02	-77,907,076.05
归属于上市公司股东的净利润	7,641,367.24	21,871,212.60	-65.06	-80,648,022.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,814,291.25	10,788,058.06	-55.37	-89,761,787.35
经营活动产生的现金流量净额	69,066,157.39	57,932,794.98	19.22	97,335,575.12
加权平均净资产收益率(%)	1.98	5.96	减少3.98个百分点	-20.56
基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	-0.51
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	-0.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	69,376,508.50	81,900,563.28	86,313,860.93	140,925,431.71
归属于上市公司股东的净利润	-4,265,023.50	6,193,658.27	3,132,309.77	2,580,422.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,109,807.33	6,098,501.38	2,298,485.06	1,527,112.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,211,042.89	18,072,539.73	16,791,968.28	38,412,692.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,114
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,280
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
合肥市创新科技风险投资有限公司	26,993,865	26,993,865	17.04	0	无	0	国有法人
铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	-18,993,865	8,079,468	5.10	0	质押	7,000,000	境内 非国 有法 人
					冻结	8,079,468	
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,036,200	1,437,300	0.91	0	无	0	其他
薛明红		590,000	0.37	0	无	0	未知
王宗君		552,400	0.35	0	无	0	未知
刘世良		520,000	0.33	0	无	0	未知
陈婉笑	171,200	442,500	0.28	0	无	0	未知
朱树俊		420,600	0.27	0	无	0	未知
李福来		415,600	0.26	0	无	0	未知
杜俊超		414,100	0.26	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥创新投系公司控股股东，三佳集团系合肥创新投的一致行动人。 公司未知除合肥创新投、三佳集团之外，上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

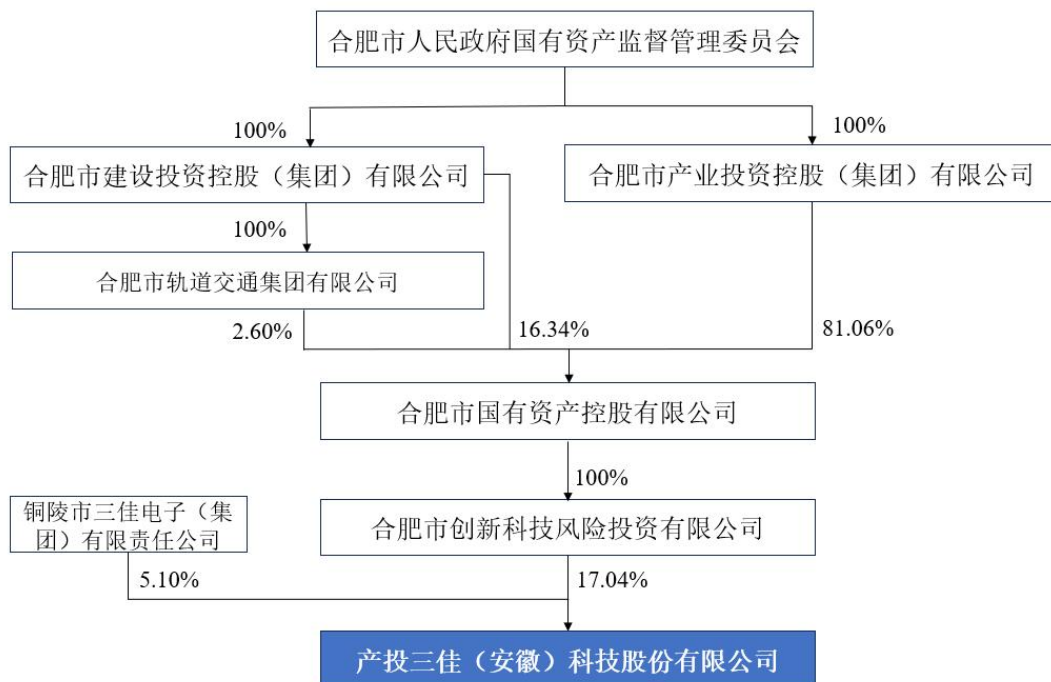
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

收购控股子公司安徽众合半导体科技有限公司（以下简称“众合半导体”）

2025年6月，公司先后召开第九届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权的议案》。公司以12,138.00万元现金，收购多家投资合伙企业及自然人合计持有的众合半导体51%股权。该交易已完成，众合半导体成为公司控股子公司，其财务报表自2025年8月起正式纳入公司合并财务报表范围。该收购事项有利于优化公司资源配置效率，提升上市公司市场占有率，增强团队研发创新能力，从而进一步提高上市公司核心竞争力，实现上市公司高质量发展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用